

NIKAPLEX[®] 高耐トラッキングガラスコンポジット (CEM-3)

High tracking resistance glass composite (CEM-3)

L-6524T600C2 (両面板)
W - Sided Copper Clad Laminates
L-6524T600C1 (片面板)
S - Sided Copper Clad Laminates

[UV遮蔽タイプ:L-6524T600C2 UV]
W - sided Copper Clad Laminates of UV shielding type:L-6524T600C2 UV

ガラス布・ガラス不織布基材エポキシ樹脂銅張積層板 (CEM-3) Glass fabric, glass non-woven fabric base epoxy resin copper-clad laminates (CEM-3)

■特徴 Characteristic

- 耐トラッキング性に優れています (CTI ≧600V以上)。 Tracking resistance is excellent (CTI ≧600V).
- 放熱性に優れています (熱伝導率 0.9 W/(m・K))。 Heat dissipation is excellent. Thermal conductivity 0.9 W/(m・K).
- パンチング加工が可能です。 Punching work is available.

■用途 Use applications

- 電源機器 For power equipment
- 屋外設置機器 For equipment of outdoor installation
- 家電 For home appliance
- アミューズメント機器 For amusement components
- LED照明機器、他 For LED lighting equipment, others

■仕様 Specification

●両面板、片面板 Copper clad laminates

品番 Products	定尺寸法 (縦×横) Standard size (Lw × Cw)	銅箔厚さ Copper foil thickness	公称板厚 Nominal thickness	厚さ許容差 Thickness tolerance	
				両面板、片面板 W / S - sided CCL	
L-6524T600C2 L-6524T600C1	1,020 ⁺¹⁰ ₋₀ × 1,020 ⁺¹⁰ ₋₀ mm	18 μm	0.8mm	±0.17	
			1.0mm	±0.18	
	1,020 ⁺¹⁰ ₋₀ × 1,220 ⁺¹⁰ ₋₀ mm	35 μm	1.2mm	±0.19	
			1.6mm	±0.19	

■一般特性例 Properties

試験項目 Item	処理条件 Treatment	単位 Unit	実測値 Actual value	
ガラス転移温度 (T _g) Glass transition temp	TMA 昇温: 10°C/min Heating rate: 10°C/min	°C	130	
	DSC 昇温: 20°C/min Heating rate: 20°C/min	°C	130	
熱膨張係数 Coefficient of thermal expansion	TMA	X	α 1	
		Y	α 1	
		Z	α 1	
			α 2	
熱分解温度 (T _d) Decomposition temp	TG/DTA法 (5%重量減少) (5% weight loss)	昇温: 20°C/min Heating rate: 20°C/min	°C	380
熱伝導率 Thermal conductivity	LF法 Laser flash method	A	W/(m・K)	0.9
比熱容量 Specific heat capacity	LF法 Laser flash method	A	J/(g・K)	1.2
はんだ耐熱性 260°C Solder heat resistance at 260°C		A	秒 sec.	≧120
T ₂₈₈ Time to delamination	TMA	TMA	分 min	25
銅箔引き剥がし強さ Peel strength	18 μm	A	N/mm	1.4
		S ₄		1.4
		A		1.8
		S ₄		1.8
曲げ強さ Flexural strength	縦 Lw / 横 Cw	A	MPa	365 / 275
曲げ弾性率 Flexural modulus	縦 Lw / 横 Cw	A	GPa	17 / 13
比誘電率 Dielectric constant (Dk)	1MHz	C-96/20/65	-	4.8
	1GHz		-	4.3
誘電正接 Disspation factor (Df)	1MHz	C-96/20/65	-	0.021
	1GHz		-	0.021
体積抵抗率 Volume resistivity		C-96/20/65	MΩ・m	1 × 10 ⁹
表面抵抗 Surface resistance		C-96/20/65	MΩ	1 × 10 ⁹
絶縁抵抗 Insulation resistance		C-96/20/65	MΩ	1 × 10 ⁹
比較トラッキング指数 (CTI値) Comparative tracking index (CTI)		A	V	≧600
吸水率 Water absorption		E-24/50 + D-24/23	%	0.04
耐アルカリ性 (3%NaOH溶液) Alkali resistance (3% NaoH aq)		40°C/3min 浸漬 Dip	-	異常なし No remarkable change
UV透過率 (UV遮蔽タイプ) UV transmittance of UV shieldeing type	UV-35	A	%	0.02
	UV-42	A	%	1.81
耐燃性 UL94 Flammability UL94		E-24/125	-	94V-0

* 1 上記試験はJIS C 6481、IPC TM650、IEC-60112、UL規格に準じます。

*1 The above tests are in accordance with JIS C6481, IPC TM650, IEC-60112, and UL.

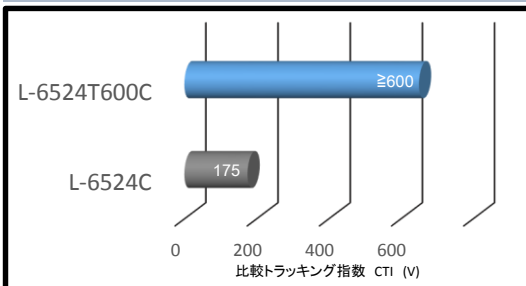
* 2 試験板厚は1.6mmです。

* 3 上記は実測値であり、保証値ではありません。

*2 The sample thickness is 1.6mm.

*3 The above data is actual values and not guaranteed values.

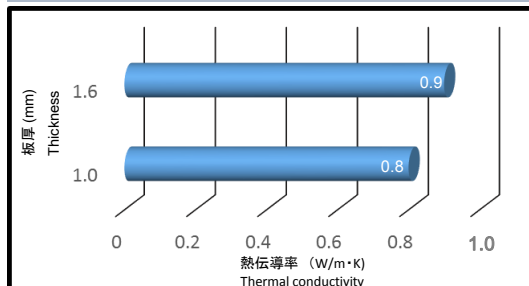
■耐トラッキング性 Comparative tracking index (CTI)



○測定方法: IEC-60112準拠
Measuring method: Conform to IEC-60112

○板厚: 1.6mm
Thickness

■熱伝導率 Thermal conductivity



○測定方法: レーザーフラッシュ法
Measuring method: Laser flash method